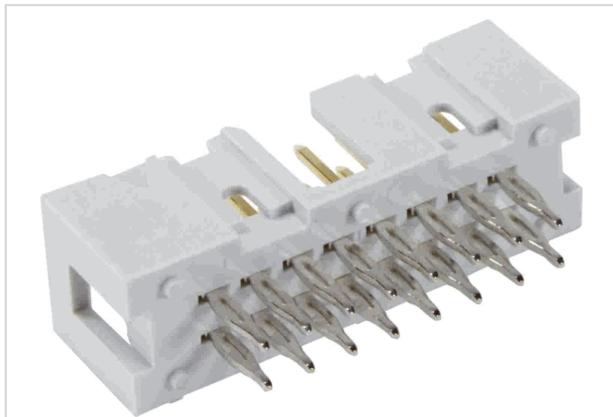


SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL2



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 18 520 6329 |
| Beschreibung | SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL2 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09185206329 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|-----------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | SEK Low-profile |
| Komponente | Messerleiste |
| Kontaktbeschreibung | gerade |

Ausführung

| | |
|--------------------|---|
| Anschlussart | Einpressanschluss |
| Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel Leiterplatte zu Leiterplatte |
| Kontaktanzahl | 20 |
| Länge der Pins | 5,5 mm |

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Steckkontaktreihen | 2 |
| Raster, anschlussseitig | 2,54 mm |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Isolationswiderstand | $>10^9 \Omega$ |
| Durchgangswiderstand | $\leq 20 \text{ m}\Omega$ |
| Grenztemperatur | -55 ... +105 °C |
| Steck- und Ziehkraft | $\leq 40 \text{ N}$ |
| Anforderungsstufe | 2 nach IEC 60603-13 |
| Steckzyklen | ≥ 250 |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Prüfspannung U_{eff} | 1 kV |
| Isolierstoffgruppe | IIIa ($175 \leq \text{CTI} < 400$) |
| Leiterplattenstärke | 1,6 mm +1,6 |

Materialeigenschaften

| | |
|--|--|
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff (PBT) |
| Farbe Einsatz | grau |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni steckseitig Ni anschlussseitig |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Antimontrioxid Nickel |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 |

Normen und Zulassungen

| | |
|---------------------|--|
| Normen | IEC 60603-13 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Bahnklassifizierung | F3/I3 |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Packungsgröße | 100 |
| Nettogewicht | 2,34 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140029811 |

Kaufmännische Daten

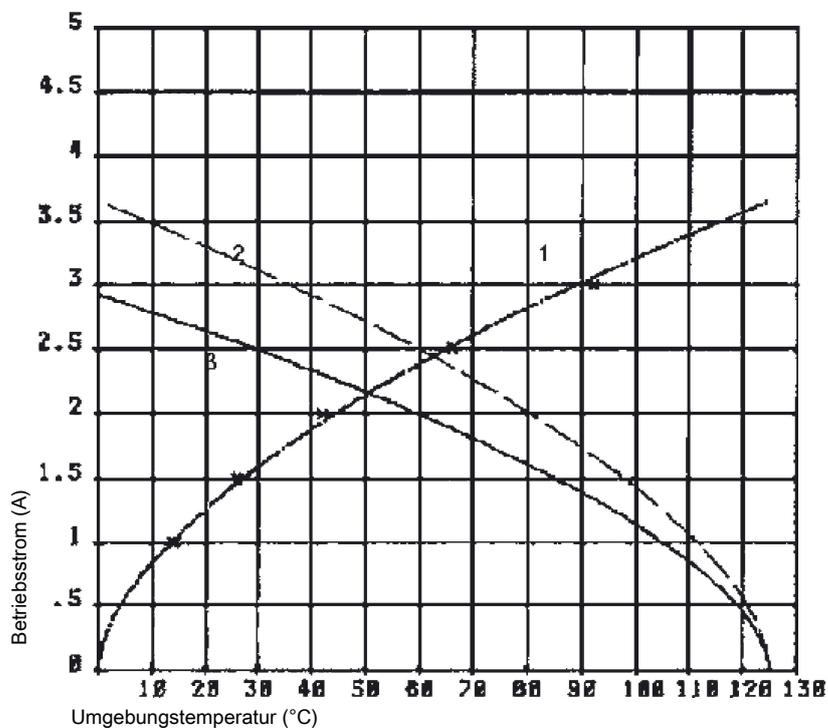
eCl@ss

27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

Derating Diagramm

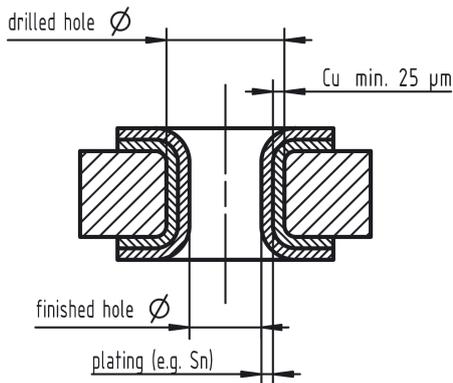
Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.

Mess- und Prüfverfahren nach IEC 60512-5-2



- ① Temperaturanstieg
- ② Deratingkurve
- ③ Deratingkurve 80%

Empfohlener Lochaufbau der Leiterplatte



| | | |
|--|----------------|----------------|
| Tin plated PCB (HAL) acc. to EN 60352-5 | Drilled hole Ø | 1,15-0,03 mm |
| | Cu | min. 25 µm |
| | Sn | max. 15 µm |
| | plated hole Ø | 0,94 - 1,09 mm |
| Chemical tin plated PCB | Drilled hole Ø | 1,15-0,03 mm |
| | Cu | min. 25 µm |
| | Sn | min. 0,8µm |
| | plated hole Ø | 1,00 - 1,10 mm |
| Gold /Nickel plated PCB | Drilled hole Ø | 1,15-0,03 mm |
| | Cu | min. 25 µm |
| | Ni | 3 - 7 µm |
| | Au | 0,05 - 0,12 µm |
| Silver plated PCB | Drilled hole Ø | 1,15-0,03 mm |
| | Cu | min. 25 µm |
| | Ag | 0,1 - 0,3 µm |
| | plated hole Ø | 1,00 - 1,10 mm |
| Copper plated PCB (OSP) | Drilled hole Ø | 1,15-0,03 mm |
| | Cu | min. 25 µm |
| | plated hole Ø | 1,00 - 1,10 mm |

Neben der Hot-Air-Level (HAL) Leiterplattenoberfläche werden neue Oberflächen immer bedeutender. Aufgrund ihrer anderen mechanischen Eigenschaften, z. B. Festigkeit und Reibkoeffizient, empfehlen wir die oben genannten Lochaufbauten.